



GLPOLY XK-P110 导热硅胶片

产品简介	产品特性	典型应用
本产品材质柔软, 高变形量, 适用于大型结构设计公差。材料表层或内层可增加强化拉伸和抗刺穿性的玻纤布或其他补强材料。加工性好, 满足异形设计的间隙填充。对金属表面无腐蚀, 是环保产品。	高导热系数 11.0W/mk 绝缘性、阻燃性能高 低热阻、低挥发 超柔软易压缩, 为低应力应用而设计	5G/6G通信、发热半导体 消费类电子、高发热量设备 汽车、工业、医疗、军工、电机电控 电子数字磁盘驱动器、航空航天、高端特种应用等

主要性能

	单位	XK-P110	测试法
补强材		/	
固有表面粘性(单双面)		双面	
颜色		灰色	目测
厚度	mm	0.5-3	ASTM D374
密度	g/cm ³	3.3	ASTM D792
硬度	Shore 00	60-80	ASTM D2240
热阻 @0.5mm 14.5psi	°Cin ² /W	0.11	ASTM D5470
导热系数	W/mk	11.0	ASTM D5470
体积电阻	Ωcm	>10 ¹³	ASTM D257
击穿强度	KV/mm	10	ASTM D149
介电常数	1	8	ASTM D150
工作温度	°C	-60~200	ASTM G166
拉伸强度	psi	10	ASTM D412
伸长率	%	>10	ASTM D412
硅氧烷 D3~D20	%	<0.05	GC-MS
阻燃性	UL94	V-0	UL94
保质期	月份	12	UL 746B, Viscosity method

特别声明：

以上所有陈述，技术信息和建议均基于本公司认为可靠的测试或经验。鉴于配方、工艺、时间、条件等的不同，许多不可控因素都可能影响产品在特定应用中的使用和性能，因此用户应做评估并根据自己的生产情况进行调整，我司不作出任何承诺。我们强烈建议您进行自己的测试试验，以确认我们产品的适用性。敝司有权对自己的产品进行改进升级，其产品有任何改动，按技术状态管理程序提前通知。

除非另有明确约定，否则对技术数据表中的信息或有关产品的任何其他书面或口头建议不承担任何责任。

